

# 1200V 400A / 600A Full SiC 파워 모듈 BSM400D12P3G002 / BSM600D12P3G001



## 한차원 높은 대전류화 실현 1200V 400A / 600A 제품 라인업 추가

### 제품 개요

낮은 인덕턴스, 저열 저항을 실현한 신개발 G Type 패키지 채용으로, 높은 정격전류 400A, 600A의 Full SiC 파워 모듈을 라인업에 추가하였습니다. 이에 따라, 산업기용 대용량 전원 및 대규모 태양광 발전, UPS 등의 대전력 어플리케이션에 검토가 가능합니다.

### 1200V 400A / 600A 대전류 타입 라인업 추가

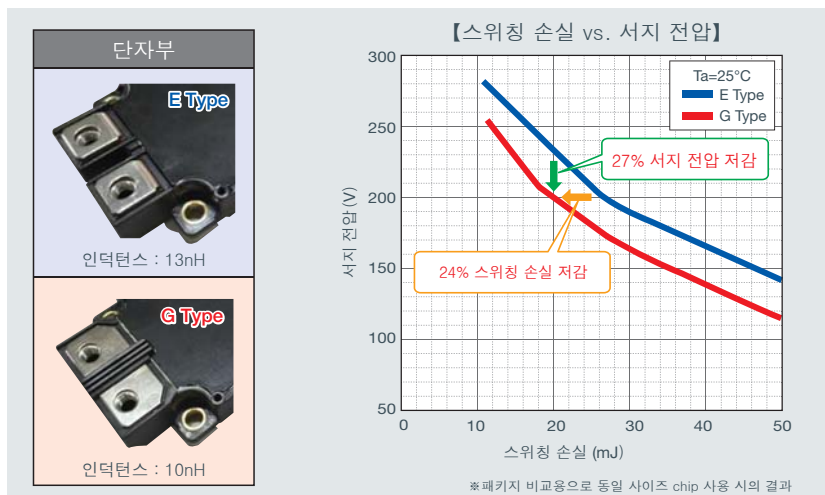
품명	절대 최대 정격 (Ta=25°C)					인덕턴스 (nH)	패키지	서미스터	내부 회로도*
	V <sub>DS</sub> (V)	V <sub>GS</sub> (V)	I <sub>o</sub> (A) (Tc=60°C)	Tj max (°C)	Tstg (°C)				
BSM080D12P2C008	1200	-6~22	80	175	-40~125	2500	C type 45.6 x 122 x 17mm	-	
BSM120D12P2C005			120						
BSM180D12P3C007			180						
BSM180D12P2E002		-4~22	180						
BSM300D12P2E001		-6~22	300						
<b>New</b> BSM400D12P3G002		-4~22	400						
<b>New</b> BSM600D12P3G001	600								

\*Chopper 타입도 구비하고 있습니다. 자세한 사항은 영업으로 문의하여 주십시오.

### 대전류화에 대응하기 위한 새로운 패키지 개발

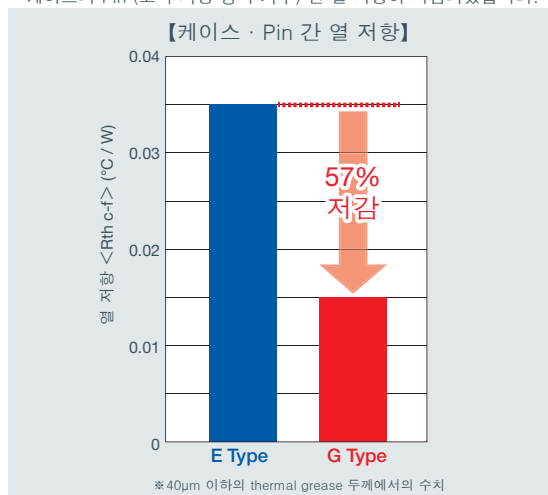
#### ●인덕턴스 저감

독자적인 신규 단자 구조 채용 및 내부 레이아웃 최적화를 통해, 내부 인덕턴스를 저감하였습니다. 이에 따라, 스위칭 시 발생하는 서지를 억제하여 대전류 사양을 실현하였습니다.



#### ●케이스 · Pin 간 열 저항 저감

냉각 기구에 대한 접합성을 향상시키기 위해, 독자적인 처리 방법으로 패키지 방열면의 평탄성을 향상시켰습니다. 이에 따라, 케이스와 Pin (고객 사용 냉각 기구) 간 열 저항이 저감되었습니다.



본 자료에 기재되어 있는 내용은 제품의 소개 자료입니다. 제품 사용 시에는 반드시 별도 사양서를 청구하시어 확인하여 주십시오. 본 자료에 기재되어 있는 정보는 정확성을 위하여 신중히 작성하였으나, 만일 해당 정보의 오류 및 오식에 기인하는 손해가 발생할 경우 당사는 그 책임을 지지 않습니다. 본 자료에 기재되어 있는 기술정보는 제품의 대표적인 동작 및 응용회로 예 등을 나타낸 것으로, 모용 또는 타사의 지적재산권 및 기타 모든 권리에 대하여 명시적으로나 묵시적으로도 그 실시 또는 이용을 허락하는 것이 아닙니다. 상기 기술정보의 사용에 기인하는 분쟁이 발생할 경우, 당사는 그 책임을 지지 않습니다. 본 자료에 기재되어 있는 제품 및 기술 중 "외국 외환 및 외국 무역법"에 해당하는 제품 또는 기술을 수출할 경우, 또는 국외에 제공할 경우에는 동일 법에 의거한 허가가 필요합니다.

본 자료의 기재 내용은 2017년 04월 18일 현재의 내용입니다.